

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-005

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于拟新建集成电路 CMP 用抛光垫项目（三期） 及年产 1 万吨集成电路制造清洗液项目的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。目前，公司正在进行两个项目的备案和环评等相关工作。

2、本次投资涉及的土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

4、公司光电半导体材料项目的技术、工艺要求和市场门槛极高，虽然公司在研发阶段做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险，具体项目的实施及推进仍存在一定的投资风险及不确定性。

一、投资项目概述

为提高湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）在光电半导体核心进口替代类工艺材料产业中的竞争实力，更好服务国内芯片制程客户及面板显示材料需求，公司拟与湖北省潜江市江汉盐化工业园管委会签署相关合作协议，拟同意公司全资子公司—湖北鼎龙汇盛新材料有限公司（暂定主体，后期可能依项

目实施需求及进展情况在公司并表子公司范围内进行实施主体调整)使用自有或自筹资金在湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园(暂定名),具体实施:集成电路CMP用抛光垫项目(三期工程50万片/年),以及年产1万吨集成电路制造清洗液项目。上述两个项目不互为条件,两个项目拟建设生产车间、检测评价楼、办公行政楼、仓库以及配套设施等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

根据《公司章程》及《对外投资及担保管理制度》等相关制度,本次投资金额在董事长审议权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体基本情况

公司名称:湖北鼎龙汇盛新材料有限公司

住所:潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号

统一社会信用代码:91429005MA49BMNRXY

成立日期:2019年10月16日

注册资本:1,000万元

法定代表人:苏敏光

经营范围:光电子产品研发、咨询、交流、转让、推广服务、制造、销售;显示器件、电子专用材料制造、销售;软件开发;企业管理咨询服务(不含金融业、投、融资咨询服务);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

股东情况:本公司持有其100%股权

三、项目基本情况

1、集成电路CMP用抛光垫项目(三期工程50万片/年)

项目名称:集成电路CMP用抛光垫项目(三期工程50万片/年)

实施地点:湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号

实施主体:湖北鼎龙汇盛新材料有限公司

建设周期:建设总工期预计为30个月,具体项目建成时间视项目进度而定。

建设内容:拟新建车间占地面积6,000平方米,建筑面积16,500平方米,购

置并安装净化系统设备、贴合机、抛光机等仪器设备共 43 台，完善配套设施。建成年产 50 万片 CMP 用抛光垫生产能力。（建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。）

投资金额：本次项目建设投资金额为16,700万元人民币，如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照公司《公司章程》、《对外投资及担保管理制度》等相关规定，另行履行相应的决策和审议程序并披露相关信息。

资金来源：公司自有或自筹资金

集成电路CMP用抛光垫项目（三期工程）的实施必要性和目的：（1）公司抛光垫下游芯片制程客户对供应链安全的要求极高，需要公司该产品在武汉厂区已有产能基础上异地建厂扩能，利于供货安全性及稳定性；（2）本次三期项目建设周期及设备采购等周期长，公司须提前布局；（3）为匹配未来海外订单拓展及需求，公司需提前进行未来产能储备；（4）丰富公司抛光垫品种，满足下游客户多样需求。

2、年产 1 万吨集成电路制造清洗液项目

项目名称：年产 1 万吨集成电路制造清洗液项目

实施地点：湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道 1 号

实施主体：湖北鼎龙汇盛新材料有限公司

建设内容：规划建筑面积 28,994 平方米，建设生产车间 4,500 平方米，办公楼 5,000 平方米及仓库，购置混配机、自动投料机、Zeta 电位仪、颗粒计数器等仪器设备 92 台，建设配套设施，建成年产清洗液 1 万吨。（建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。）

建设周期：建设总工期预计为 30 个月，具体项目建成时间视项目进度而定。

投资金额：本次项目建设首期投资为 20,000 万元人民币（项目总计划投资额预计为 40,000 万元人民币，拟分两期实施），该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照公司《公司章程》、《对外投资及担保管理制度》等相关规定，另行履行相应的决策和审议程序并披露相关信息。

资金来源：公司自有或自筹资金

集成电路制造清洗液项目的实施必要性和目的：公司近年一直围绕集成电路核心 CMP 全局平坦化工艺材料作为发展重点和延展方向，相关进展符合公司

预期。经过几年鼎龙旗下专业化团队的持续研发及客户测试、产业化前期准备，公司清洗液项目具备产业化实施条件。随着逻辑客户制程不断缩进和存储客户抛光层数的不断增加，对高端清洗液的需求将不断提高，先进制程的高端清洗液绝大多数掌握在两家美国公司手中，公司拟实施 CMP 后清洗液（即：金属薄膜抛光后配方清洗液）和光刻胶蚀刻后清洗液项目的产业化，将有效解决国内该系列产品严重依赖海外进口的卡脖子问题。

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司子公司湖北鼎龙汇盛新材料有限公司拟投资建设集成电路CMP用抛光垫项目（三期工程50万片/年）与年产1万吨集成电路制造清洗液项目，符合国家光电半导体产业相关政策和公司战略发展规划，有利于进一步优化产能布局，促进产业技术升级，丰富公司光电半导体材料品种，扩大公司光电半导体材料产品的市场规模，满足市场需求，提升公司整体竞争能力和持续盈利能力。

2、对公司的影响

本次投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于完善公司的产业布局，能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司2021年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。

五、风险提示

1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。目前，公司正在进行两个项目的备案和环评环评等相关工作。

2、本次投资涉及的土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存

在不确定性。

4、公司光电半导体材料项目的技术、工艺要求和市场门槛极高，虽然公司在研发阶段做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险，具体项目的实施及推进仍存在一定的投资风险及不确定性。

针对上述风险，公司将与潜江市江汉盐化工业园管委会及当地相关管理部门积极沟通对接，尽快完成相关手续办理；选调具有丰富工程建设经验的管理骨干组成项目专班，负责工程建设期间管理，严格把控项目建设进度，保障工程进度和质量等措施对风险进行控制。

公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年1月15日